

2-1-2-17 SR 擦り付け付着／擦上并附着 SR / Soils rubbed on solder resist surface

【特徴】SR 表面にSR インクやシルクインクなどが擦り付けられた様相で付着している状態の欠陥

【特征】在SR 表面有擦上并附着SR 或者字符油墨摸样的缺陷。

【Characteristics】Solder resist ink or legend ink which appears to be rubbed on the solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 表面にSR インクやシルクインクなどが誤って擦りつけられたことにより出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】差错地在SR 表面擦上并附着SR 或者字符油墨而造成的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Solder resist or legend ink is carelessly rubbed on the solder resist surface. (After solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率 ×20

【Comments】
Magnification: ×20



【コメント】
端子表面への僅かなSR 付着
顕微鏡倍率×

【注釋】
插脚表面擦上少量的SR
显微镜倍率 ×

【Comments】
A small amount of little solder resist adhered to edge board contact
Magnification: ×

2-1-2-18 SR 滴下引ずり付着／滴下SR 并拖拉 / Ink drop and run on solder resist surface

【特徴】SR 表面に滴下し糸引きした様相で、付着しているSR 汚れ欠陥

【特征】在SR 表面有被滴下并拖拉成为纒丝状的SR 沾污的缺陷。

【Characteristics】Soiling by adhered solder resist which appears to drop and run on the solder resist surface

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 塗布後の表面に液状のSR インクを誤って滴下させ糸引き状に付着させてしまったことにより出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】错误地让SR 油墨滴下到涂布后的表面并拖拉成为纒丝状所引起的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Solder resist ink is carelessly dropped and run in threads on the coated solder resist surface (After solder resist application process)



【コメント】
顕微鏡倍率×55

【注釋】
显微镜倍率 ×55

【Comments】
Magnification: ×55



【コメント】
顕微鏡倍率×40

【注釋】
显微镜倍率 ×40

【Comments】
Magnification: ×40